

中国物联网芯片行业现状深度分析与投资趋势研究报告（2025-2032年）

报告大纲

观研报告网

www.chinabaogao.com

一、报告简介

观研报告网发布的《中国物联网芯片行业现状深度分析与投资趋势研究报告（2025-2032年）》涵盖行业最新数据，市场热点，政策规划，竞争情报，市场前景预测，投资策略等内容。更辅以大量直观的图表帮助本行业企业准确把握行业发展态势、市场商机动向、正确制定企业竞争战略和投资策略。本报告依据国家统计局、海关总署和国家信息中心等渠道发布的权威数据，以及我中心对本行业的实地调研，结合了行业所处的环境，从理论到实践、从宏观到微观等多个角度进行市场调研分析。

官网地址：<http://www.chinabaogao.com/baogao/202507/757954.html>

报告价格：电子版: 8200元 纸介版：8200元 电子和纸介版: 8500

订购电话: 400-007-6266 010-86223221

电子邮箱: sales@chinabaogao.com

联系人: 客服

特别说明：本PDF目录为计算机程序生成，格式美观性可能有欠缺；实际报告排版规则、美观。

二、报告目录及图表目录

物联网芯片是一种嵌入式芯片，具备无线通信和数据处理能力，能够接收传感器或其他设备采集的数据，并通过无线网络与其他设备进行数据传输和交互。它是实现物联网应用中的通信、计算和控制功能的核心部件。

一、我国物联网芯片产业链

从产业链来看，物联网芯片上游为原材料和相关生产设备；其中原材料包括硅片、靶材、光刻胶、抛光材料、封装材料等；设备包括硅片晶炉、热处理设备、光刻机、涂胶显影机、刻蚀设备、检测设备、封装设备等。中游为物联网芯片的设计及制造。下游为智慧城市、智能穿戴、工业物联网、消费电子和车联网等应用领域。

资料来源：观研天下整理

从物联网芯片产业链布局情况来看，我国物联网芯片上游原材料参与企业有中芯国际、中环股份、南大光电、华特气体、隆华科技、飞凯材料等等；设备参与企业有晶盛机电、北方华创、芯源微、电科装备、凯世通等。中游物联网芯片设计和制造布局企业有中兴通讯、泰凌微、士兰微、紫光展锐、恒玄科技、兆易创新等企业。下游为智慧城市、智能穿戴、工业物联网、消费电子和车联网等应用领域。

资料来源：观研天下整理

二、我国物联网芯片行业上游相关企业竞争优势对比

我国物联网芯片行业上游原材料参与企业有中芯国际 (688981)、南大光电 (300346)、华特气体 (688268)；设备参与的企业有晶盛机电 (300316)、北方华创 (002371)、芯源微 (688037)等。

我国物联网芯片行业上游相关企业竞争优势对比

/

企业简称

成立时间

竞争优势

原材料

中芯国际 (688981)

2000-04-03

研发团队优势：公司研发队伍的主要成员由境内外资深专家组成,拥有在行业内多年的研发和管理经验。

规模及生产优势：中芯国际总部位于中国上海,拥有全球化的制造和服务基地,在上海、北京

、天津、深圳建有多座8英寸和12英寸晶圆厂。

南大光电 (300346)

2000-12-28

技术优势：公司及主要子公司自主开发的专利共计130项,其中发明专利37项,实用新型专利93项。

研发优势：公司在江苏苏州、浙江宁波、安徽全椒、山东淄博、内蒙古乌兰察布设立研发生产基地,在北美设立营销技术服务分公司。

华特气体 (688268)

2019-12-26

客户优势：公司解决了长江存储、中芯国际、华润微电子、合肥长鑫等众多知名半导体客户多种气体材料的进口制约,并进入了英特尔、美光科技、台积电、SK海力士、英飞凌、三星等全球领先半导体企业的供应链体系。

技术优势：公司掌握了特种气体从生产、存储、检测到应用服务全流程涉及到的关键性技术,包括气体合成、纯化、混配、气瓶处理、分析检测以及供气系统的设计、安装、日常维护等环节。

设备

晶盛机电 (300316)

2006-12-14

客户优势：公司的主要客户包括 TCL 中环、有研硅、上海新昇、奕斯伟、合晶科技、晶科能源、天合光能、晶澳科技、通威股份、上机数控、高景太阳能、双良节能、美科股份等业内知名的上市公司或大型企业,并与公司保持了长期的战略合作关系。

人才优势：公司拥有一支以教授、博士、硕士为核心的研发与管理团队,拥有国家级博士后工作站、外国专家工作站、院士工作站以及省级重点研究院等科研人才平台,以及一支专业化程度高、应用经验丰富、执行力强的技术工人队伍,

北方华创 (002371)

2001-09-28

技术优势：截至 2022 年末公司累计申请专利 6800 余件,累计获得授权专利 3900 余件。

研发优势：公司现有六大研发生产基地,营销服务体系覆盖欧、美、亚等全球主要国家和地区。

芯源微 (688037)

2002-12-17

技术优势：截至 2023 年 6 月 30 日,公司共获得专利授权 265 项,其中发明专利 177 项(中国大陆地区发明专利 158 项,中国台湾地区发明专利 17 项,美国发明专利 2 项),实用新型专利 52 项,外观设计专利 36 项;拥有软件著作权 76 项。

销售优势：公司以沈阳为销售总部,并在苏州、昆山、武汉、上海、中国台湾等地设有办事

处,销售网络覆盖长三角、珠三角及中国台湾地区等产业重点区域,建立了可快速响应的销售和技术服务团队。

资料来源：公司资料、观研天下整理

三、中国物联网芯片行业中游主要企业竞争优势情况

我国物联网芯片行业中游设计及制造参与的企业有中兴通讯 (000063)、泰凌微 (688591)、士兰微(600460)、紫光展锐、恒玄科技 (688608)、兆易创新 (603986)。

我国物联网芯片行业中游相关企业竞争优势对比

/

企业简称

成立时间

竞争优势

物联网芯片设计及制造

中兴通讯 (000063)

1997-11-11

技术优势：在芯片领域,本集团具有近30年的研发积累,在先进工艺设计、核心IP、架构和封装设计、数字化高效开发平台等方面持续强化投入,已具备业界领先的芯片全流程设计能力。

业务优势：公司业务覆盖160多个国家和地区,服务全球1/4以上人口。

泰凌微 (688591)

2010-06-30

客户优势：产品广泛应用于汉朔、小米、罗技(Logitech)、欧之(Home Control)、涂鸦智能、朗德万斯(Ledvance)、瑞萨(Renesas)、科大讯飞、创维、夏普(Sharp)、松下(Panasonic)、英伟达(Nvidia)、哈曼(Harman)等多家主流终端知名品牌。

品牌优势：在品牌声誉方面,公司通过技术创新、品质保证、应用场景拓展等全方面积累,打造了优秀的品牌知名度,获得了“五大中国创新IC设计公司”“中国IC设计无线连接公司TOP10”“上海市市级企业技术中心和科技小巨人企业”等荣誉,多款系列产品也取得“上海市物联网重点产品奖”“中国芯”“年度最佳RF/无线IC”等众多奖项。

士兰微 (600460)

1997-09-25

研发优势：公司已经建立了可持续发展的产品和技术研发体系。

产能优势：士兰微电子建在杭州钱塘新区的集成电路芯片生产线目前实际月产出达到23万片,在小于和等于6英寸的芯片制造产能中排在全球第二位。

紫光展锐

20130-08-26

技术优势：公司曾多次获得国家科学技术进步奖，其中特等奖1次、一等奖2次，累计申请专

利超11000项，拥有3G/4G/5G、多卡多待、多模等核心专利。

客户优势：公司测覆盖全球140+国家和地区，通过全球270+运营商的出货认证，拥有包括荣耀、小米、realme、vivo、三星、摩托罗拉、海信、中兴、京东、银联、格力在内的500多家品牌客户。

恒玄科技 (688608)

2015-06-08

技术优势：2022年上半年,公司新增申请境内发明专利66项,获得境内发明专利批准19项;通过自主途径申请境外专利3项,获得境外发明专利批准3项。

布局优势：公司研发团队具有丰富的行业经验和敏锐的市场洞察力,把握住了智能语音市场爆发的机遇。

兆易创新 (603986)

2005-04-06

营销网络优势：公司在中国北京、上海、深圳、合肥、西安、成都、苏州、香港和台湾,美国、韩国、日本、英国、新加坡等多个国家和地区均设有分支机构和办事处,营销网络遍布全球,为客户提供优质便捷的本地化支持服务。

多元化布局优势：公司在产品线规划、下游应用领域扩展、市场区域开发等方面,坚持多元化布局。

资料来源：企业资料、观研天下整理（XD）

注：上述信息仅供参考，图表均为样式展示，具体数据、坐标轴与数据标签详见报告正文。

个别图表由于行业特性可能会有出入，具体内容请联系客服确认，以报告正文为准。

更多图表和内容详见报告正文。

观研报告网发布的《中国物联网芯片行业现状深度分析与投资趋势研究报告（2025-2032年）》涵盖行业最新数据，市场热点，政策规划，竞争情报，市场前景预测，投资策略等内容。更辅以大量直观的图表帮助本行业企业准确把握行业发展态势、市场商机动向、正确制定企业竞争战略和投资策略。

本报告依据国家统计局、海关总署和国家信息中心等渠道发布的权威数据，结合了行业所处的环境，从理论到实践、从宏观到微观等多个角度进行市场调研分析。

行业报告是业内企业、相关投资公司及政府部门准确把握行业发展趋势，洞悉行业竞争格局，规避经营和投资风险，制定正确竞争和投资战略决策的重要决策依据之一。

本报告是全面了解行业以及对本行业进行投资不可或缺的重要工具。观研天下是国内知名的行业信息咨询机构，拥有资深的专家团队，多年来已经为上万家企业单位、咨询机构、金融

机构、行业协会、个人投资者等提供了专业的行业分析报告，客户涵盖了华为、中国石油、中国电信、中国建筑、惠普、迪士尼等国内外行业领先企业，并得到了客户的广泛认可。

目录大纲：

【第一部分 行业定义与监管】

第一章 2020-2024年中国物联网芯片行业发展概述

第一节 物联网芯片行业发展情况概述

一、物联网芯片行业相关定义

二、物联网芯片特点分析

三、物联网芯片行业基本情况介绍

四、物联网芯片行业经营模式

（1）生产模式

（2）采购模式

（3）销售/服务模式

五、物联网芯片行业需求主体分析

第二节 中国物联网芯片行业生命周期分析

一、物联网芯片行业生命周期理论概述

二、物联网芯片行业所属的生命周期分析

第三节 物联网芯片行业经济指标分析

一、物联网芯片行业的赢利性分析

二、物联网芯片行业的经济周期分析

三、物联网芯片行业附加值的提升空间分析

第二章 中国物联网芯片行业监管分析

第一节 中国物联网芯片行业监管制度分析

一、行业主要监管体制

二、行业准入制度

第二节 中国物联网芯片行业政策法规

一、行业主要政策法规

二、主要行业标准分析

第三节 国内监管与政策对物联网芯片行业的影响分析

【第二部分 行业环境与全球市场】

第三章 2020-2024年中国物联网芯片行业发展环境分析

第一节 中国宏观环境与对物联网芯片行业的影响分析

一、中国宏观经济环境

二、中国宏观经济环境对物联网芯片行业的影响分析

第二节 中国社会环境与对物联网芯片行业的影响分析

第三节 中国对外贸易环境与对物联网芯片行业的影响分析

第四节 中国物联网芯片行业投资环境分析

第五节 中国物联网芯片行业技术环境分析

第六节 中国物联网芯片行业进入壁垒分析

一、物联网芯片行业资金壁垒分析

二、物联网芯片行业技术壁垒分析

三、物联网芯片行业人才壁垒分析

四、物联网芯片行业品牌壁垒分析

五、物联网芯片行业其他壁垒分析

第七节 中国物联网芯片行业风险分析

一、物联网芯片行业宏观环境风险

二、物联网芯片行业技术风险

三、物联网芯片行业竞争风险

四、物联网芯片行业其他风险

第四章 2020-2024年全球物联网芯片行业发展现状分析

第一节 全球物联网芯片行业发展历程回顾

第二节 全球物联网芯片行业市场规模与区域分布情况

第三节 亚洲物联网芯片行业地区市场分析

一、亚洲物联网芯片行业市场现状分析

二、亚洲物联网芯片行业市场规模与市场需求分析

三、亚洲物联网芯片行业市场前景分析

第四节 北美物联网芯片行业地区市场分析

一、北美物联网芯片行业市场现状分析

二、北美物联网芯片行业市场规模与市场需求分析

三、北美物联网芯片行业市场前景分析

第五节 欧洲物联网芯片行业地区市场分析

一、欧洲物联网芯片行业市场现状分析

二、欧洲物联网芯片行业市场规模与市场需求分析

三、欧洲物联网芯片行业市场前景分析

第六节 2025-2032年全球物联网芯片行业分布走势预测

第七节 2025-2032年全球物联网芯片行业市场规模预测

【第三部分 国内现状与企业案例】

第五章 中国物联网芯片行业运行情况

第一节 中国物联网芯片行业发展状况情况介绍

一、行业发展历程回顾

二、行业创新情况分析

三、行业发展特点分析

第二节 中国物联网芯片行业市场规模分析

一、影响中国物联网芯片行业市场规模的因素

二、中国物联网芯片行业市场规模

三、中国物联网芯片行业市场规模解析

第三节 中国物联网芯片行业供应情况分析

一、中国物联网芯片行业供应规模

二、中国物联网芯片行业供应特点

第四节 中国物联网芯片行业需求情况分析

一、中国物联网芯片行业需求规模

二、中国物联网芯片行业需求特点

第五节 中国物联网芯片行业供需平衡分析

第六节 中国物联网芯片行业存在的问题与解决策略分析

第六章 中国物联网芯片行业产业链及细分市场分析

第一节 中国物联网芯片行业产业链综述

一、产业链模型原理介绍

二、产业链运行机制

三、物联网芯片行业产业链图解

第二节 中国物联网芯片行业产业链环节分析

一、上游产业发展现状

二、上游产业对物联网芯片行业的影响分析

三、下游产业发展现状

四、下游产业对物联网芯片行业的影响分析

第三节 中国物联网芯片行业细分市场分析

一、细分市场一

二、细分市场二

第七章 2020-2024年中国物联网芯片行业市场竞争分析

第一节 中国物联网芯片行业竞争现状分析

一、中国物联网芯片行业竞争格局分析

二、中国物联网芯片行业主要品牌分析

第二节 中国物联网芯片行业集中度分析

一、中国物联网芯片行业市场集中度影响因素分析

二、中国物联网芯片行业市场集中度分析

第三节 中国物联网芯片行业竞争特征分析

一、企业区域分布特征

二、企业规模分布特征

三、企业所有制分布特征

第八章 2020-2024年中国物联网芯片行业模型分析

第一节 中国物联网芯片行业竞争结构分析（波特五力模型）

一、波特五力模型原理

二、供应商议价能力

三、购买者议价能力

四、新进入者威胁

五、替代品威胁

六、同业竞争程度

七、波特五力模型分析结论

第二节 中国物联网芯片行业SWOT分析

一、SWOT模型概述

二、行业优势分析

三、行业劣势

四、行业机会

五、行业威胁

六、中国物联网芯片行业SWOT分析结论

第三节 中国物联网芯片行业竞争环境分析（PEST）

一、PEST模型概述

二、政策因素

三、经济因素

四、社会因素

五、技术因素

六、PEST模型分析结论

第九章 2020-2024年中国物联网芯片行业需求特点与动态分析

第一节 中国物联网芯片行业市场动态情况

第二节 中国物联网芯片行业消费市场特点分析

一、需求偏好

二、价格偏好

三、品牌偏好

四、其他偏好

第三节 物联网芯片行业成本结构分析

第四节 物联网芯片行业价格影响因素分析

一、供需因素

二、成本因素

三、其他因素

第五节 中国物联网芯片行业价格现状分析

第六节 2025-2032年中国物联网芯片行业价格影响因素与走势预测

第十章 中国物联网芯片行业所属行业运行数据监测

第一节 中国物联网芯片行业所属行业总体规模分析

一、企业数量结构分析

二、行业资产规模分析

第二节 中国物联网芯片行业所属行业产销与费用分析

一、流动资产

二、销售收入分析

三、负债分析

四、利润规模分析

五、产值分析

第三节 中国物联网芯片行业所属行业财务指标分析

一、行业盈利能力分析

二、行业偿债能力分析

三、行业营运能力分析

四、行业发展能力分析

第十一章 2020-2024年中国物联网芯片行业区域市场现状分析

第一节 中国物联网芯片行业区域市场规模分析

一、影响物联网芯片行业区域市场分布的因素

二、中国物联网芯片行业区域市场分布

第二节 中国华东地区物联网芯片行业市场分析

一、华东地区概述

二、华东地区经济环境分析

三、华东地区物联网芯片行业市场分析

（1）华东地区物联网芯片行业市场规模

（2）华东地区物联网芯片行业市场现状

（3）华东地区物联网芯片行业市场规模预测

第三节 华中地区市场分析

一、华中地区概述

二、华中地区经济环境分析

三、华中地区物联网芯片行业市场分析

（1）华中地区物联网芯片行业市场规模

（2）华中地区物联网芯片行业市场现状

（3）华中地区物联网芯片行业市场规模预测

第四节 华南地区市场分析

一、华南地区概述

二、华南地区经济环境分析

三、华南地区物联网芯片行业市场分析

（1）华南地区物联网芯片行业市场规模

（2）华南地区物联网芯片行业市场现状

（3）华南地区物联网芯片行业市场规模预测

第五节 华北地区物联网芯片行业市场分析

一、华北地区概述

二、华北地区经济环境分析

三、华北地区物联网芯片行业市场分析

（1）华北地区物联网芯片行业市场规模

（2）华北地区物联网芯片行业市场现状

（3）华北地区物联网芯片行业市场规模预测

第六节 东北地区市场分析

一、东北地区概述

二、东北地区经济环境分析

三、东北地区物联网芯片行业市场分析

（1）东北地区物联网芯片行业市场规模

（2）东北地区物联网芯片行业市场现状

(3) 东北地区物联网芯片行业市场规模预测

第七节 西南地区市场分析

一、西南地区概述

二、西南地区经济环境分析

三、西南地区物联网芯片行业市场分析

(1) 西南地区物联网芯片行业市场规模

(2) 西南地区物联网芯片行业市场现状

(3) 西南地区物联网芯片行业市场规模预测

第八节 西北地区市场分析

一、西北地区概述

二、西北地区经济环境分析

三、西北地区物联网芯片行业市场分析

(1) 西北地区物联网芯片行业市场规模

(2) 西北地区物联网芯片行业市场现状

(3) 西北地区物联网芯片行业市场规模预测

第九节 2025-2032年中国物联网芯片行业市场规模区域分布预测

第十二章 物联网芯片行业企业分析（随数据更新可能有调整）

第一节 企业一

一、企业概况

二、主营产品

三、运营情况

(1) 主要经济指标情况

(2) 企业盈利能力分析

(3) 企业偿债能力分析

(4) 企业运营能力分析

(5) 企业成长能力分析

四、公司优势分析

第二节 企业二

一、企业概况

二、主营产品

三、运营情况

(1) 主要经济指标情况

(2) 企业盈利能力分析

(3) 企业偿债能力分析

(4) 企业运营能力分析

(5) 企业成长能力分析

四、公司优势分析

第三节 企业三

一、企业概况

二、主营产品

三、运营情况

(1) 主要经济指标情况

(2) 企业盈利能力分析

(3) 企业偿债能力分析

(4) 企业运营能力分析

(5) 企业成长能力分析

四、公司优势分析

第四节 企业四

一、企业概况

二、主营产品

三、运营情况

(1) 主要经济指标情况

(2) 企业盈利能力分析

(3) 企业偿债能力分析

(4) 企业运营能力分析

(5) 企业成长能力分析

四、公司优势分析

第五节 企业五

一、企业概况

二、主营产品

三、运营情况

(1) 主要经济指标情况

(2) 企业盈利能力分析

(3) 企业偿债能力分析

(4) 企业运营能力分析

(5) 企业成长能力分析

四、公司优势分析

第六节 企业六

一、企业概况

二、主营产品

三、运营情况

（1）主要经济指标情况

（2）企业盈利能力分析

（3）企业偿债能力分析

（4）企业运营能力分析

（5）企业成长能力分析

四、公司优势分析

第七节 企业七

一、企业概况

二、主营产品

三、运营情况

（1）主要经济指标情况

（2）企业盈利能力分析

（3）企业偿债能力分析

（4）企业运营能力分析

（5）企业成长能力分析

四、公司优势分析

第八节 企业八

一、企业概况

二、主营产品

三、运营情况

（1）主要经济指标情况

（2）企业盈利能力分析

（3）企业偿债能力分析

（4）企业运营能力分析

（5）企业成长能力分析

四、公司优势分析

第九节 企业九

一、企业概况

二、主营产品

三、运营情况

（1）主要经济指标情况

（2）企业盈利能力分析

（3）企业偿债能力分析

(4) 企业运营能力分析

(5) 企业成长能力分析

四、公司优势分析

第十节 企业十

一、企业概况

二、主营产品

三、运营情况

(1) 主要经济指标情况

(2) 企业盈利能力分析

(3) 企业偿债能力分析

(4) 企业运营能力分析

(5) 企业成长能力分析

四、公司优势分析

【第四部分 展望、结论与建议】

第十三章 2025-2032年中国物联网芯片行业发展前景分析与预测

第一节 中国物联网芯片行业未来发展前景分析

一、中国物联网芯片行业市场机会分析

二、中国物联网芯片行业投资增速预测

第二节 中国物联网芯片行业未来发展趋势预测

第三节 中国物联网芯片行业规模发展预测

一、中国物联网芯片行业市场规模预测

二、中国物联网芯片行业市场规模增速预测

三、中国物联网芯片行业产值规模预测

四、中国物联网芯片行业产值增速预测

五、中国物联网芯片行业供需情况预测

第四节 中国物联网芯片行业盈利走势预测

第十四章 中国物联网芯片行业研究结论及投资建议

第一节 观研天下中国物联网芯片行业研究综述

一、行业投资价值

二、行业风险评估

第二节 中国物联网芯片行业进入策略分析

一、目标客户群体

二、细分市场选择

三、区域市场的选择

第三节 物联网芯片行业品牌营销策略分析

一、物联网芯片行业产品策略

二、物联网芯片行业定价策略

三、物联网芯片行业渠道策略

四、物联网芯片行业推广策略

第四节 观研天下分析师投资建议

详细请访问：<http://www.chinabaogao.com/baogao/202507/757954.html>